

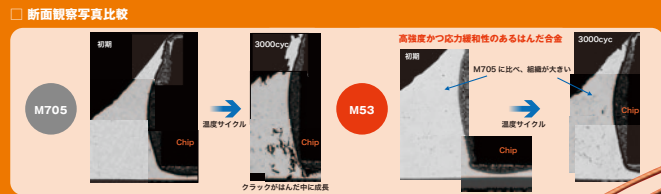
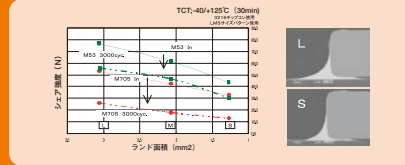
M53 車載搭載製品の軽薄短小化にも対応『M53』ペースト

- 特長**
- 耐熱疲労特性に優れ、過酷な使用条件でも高い接合強度を維持
 - 熱疲労によるクラック進展を抑制、長期使用でも電気伝導を維持
 - ランド面積の小さな軽薄短小化設計でも高い品質を確保

製品仕様



□ 小さなランドでも強度を確保



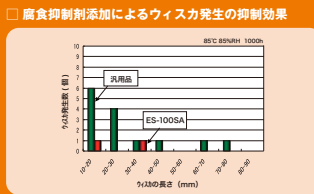
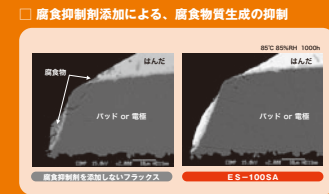
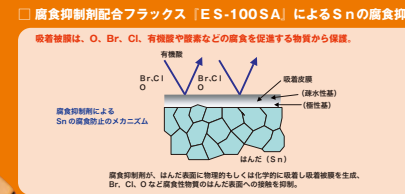
SMIC
Senju Metal Industry Co., Ltd.

腐食起因のウィスカを抑制する『ES-100SA』

特許：4325746

ES-100SA

製品仕様



特長

- 高温高湿下での、腐食が原因で発生するウィスカを抑制
- フラックスに添加した腐食抑制剤がはんだ表面に吸着し、高温高湿環境下での酸化を抑制
- ウィスカ発生の起因となるハロゲン成分を減量しつつ、はんだ濡れ性を確保
- 酸化抑制剤を有するフラックスで、ウィスカ発生を低減
- フラックス残渣は、非腐食性で信頼性に優れており、無洗浄での使用に適しております



自動車

AUTOMOBILE

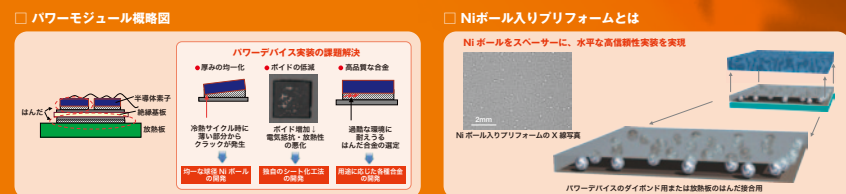


次世代実装を、信頼でつなぐ

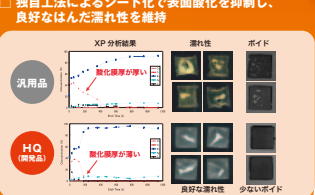
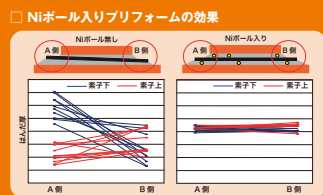
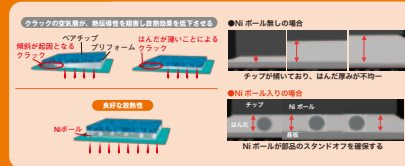
特長

- はんだのクラック発生を抑制し、高放熱性を実現
- はんだ厚や傾斜に起因するクラックを抑制し、高放熱性を実現
- プリフォームによる一定のはんだ厚の確保とボイド低減で、高放熱性を実現
- 傾斜なきベアチップで、信頼性の高いワイヤーボンディングを実現

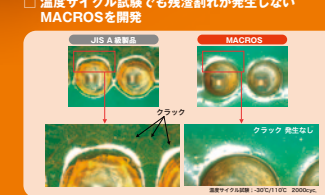
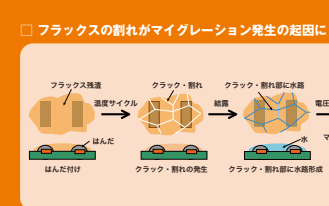
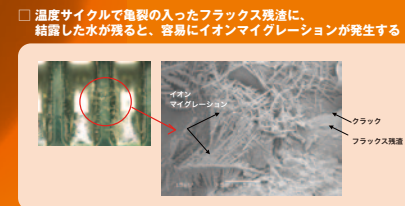
製品仕様



□ 高い放熱効果

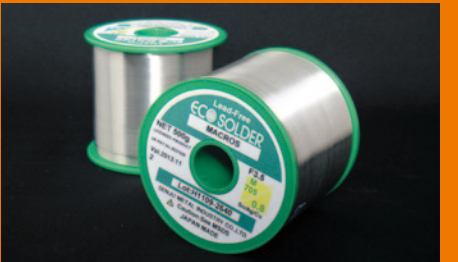


製品仕様



特長

- 車載など温度変化が激しい環境でも、フラックス残渣が割れない
- 接着力と撥水性が高いフラックス残渣が、マイグレーションの発生を抑制
- レーザーはんだ付けに優れ、レーザー固有のフラックス飛散が発生しない



HQ 水平実装で、高放熱特性を約束する『Niボール入りプリフォーム』

Smart Connection

結露起因のマイグレーションを防止する『MACROS』

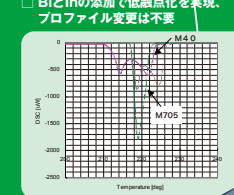
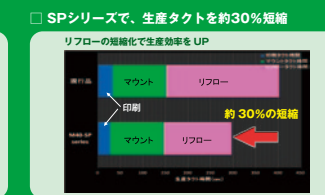
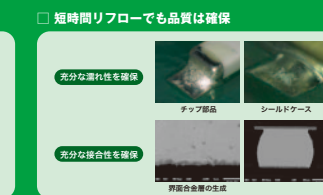
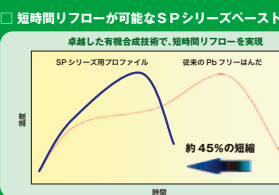
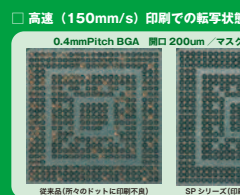
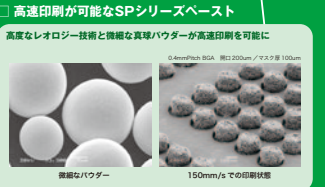
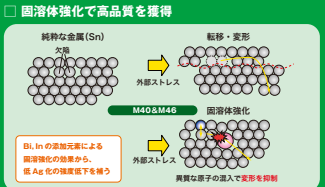
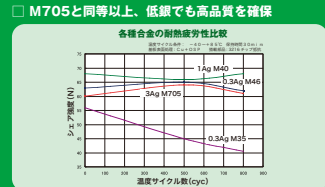
MACROS

M40 & M46 コストを、徹底的に削減できる『M40』SPシリーズ

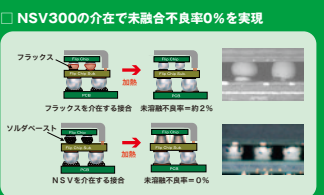
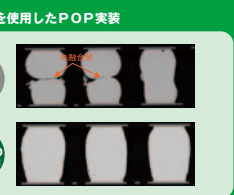
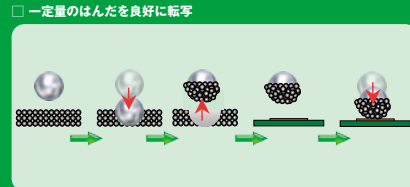
特長

- 高品質な低銀化を達成
- プロファイルの変更が必要
- 高速印刷が可能
- 短時間リフローが可能
- 生産歩留が安定

製品仕様

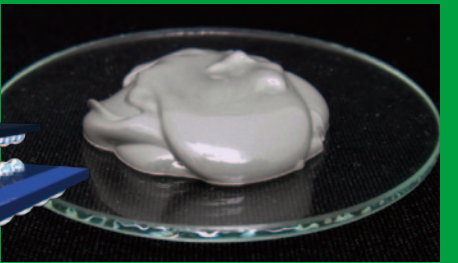


製品仕様



特長

- Ball to Ball 実装での「未融合解決」
- 良好な転写性を有し、Ball-Ball 実装での未融合を激減
- POPやTMV Packageにも対応し、良好なはんだ付け性を実現
- 反りに強く、ハロゲンフリーでありながら、従来製品以上の性能



スマートフォン

SMARTPHONE

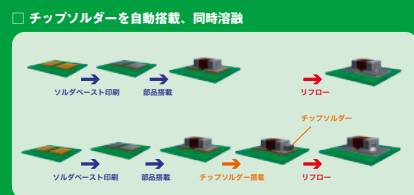


夢のイノベーションを、明日につなぐ

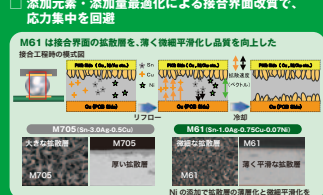
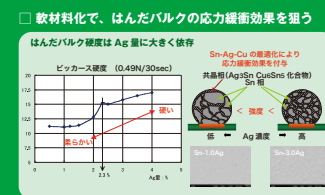
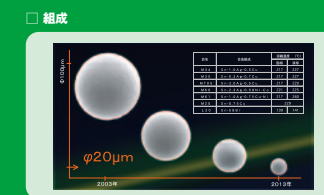
特長

- はんだ量の不足が予測される実装に0402サイズもラインナップ
- SMDと同時に自動搭載可能なテーピング仕様
- ソルダペーストと同時に溶融、追いはんだ付けが必要
- 適切なはんだ量の供給で、高い接続信頼性を確保

製品仕様

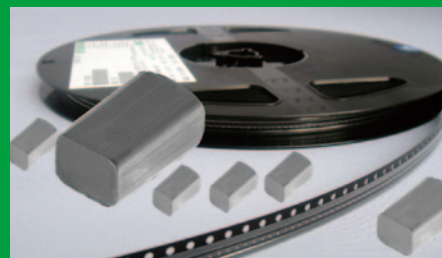
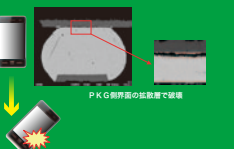


製品仕様



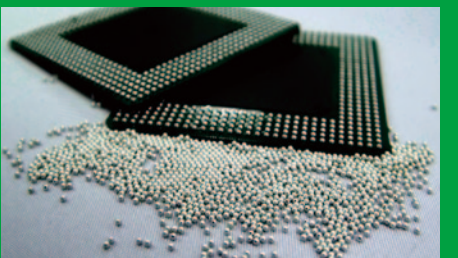
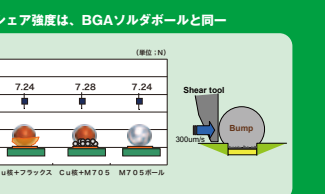
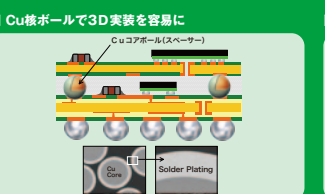
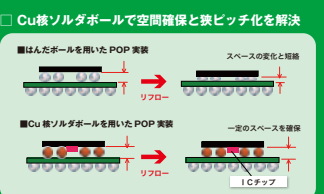
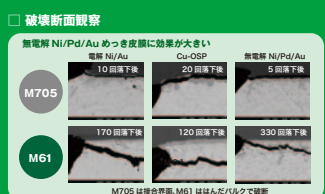
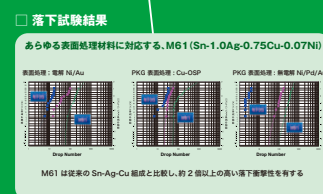
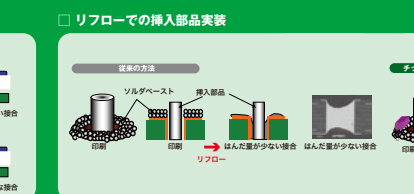
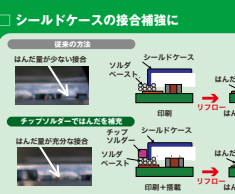
特長

- モバイル機器など、落下のリスクの高い製品に
- 耐落下衝撃性に優れたソルダボール
- 微細接続、高密度接続、高品質実装に対応
- あらゆる表面処理材料に対応



□ チップソルダー寸法公差

	l	w	t
0402	±0.05	±0.05	±0.05
05025	±0.05	±0.05	±0.05
0603	±0.1	±0.1	±0.05
1005	±0.1	±0.1	±0.05
1608	±0.1	±0.1	±0.05



チップソルダー はんだ量の不足が予測されるランドに『チップソルダー』を

Smart Connection

耐落下衝撃性に優れた『M61』ソルダボール

M61 & Cu核ボール